

5254181406 BF II IA

ENGLISH

One Component Self-Etching Light-Cured Dental Adhesive

TOKUYAMA BOND FORCE II

REF AD01

Türkçe.....

Kullanmadan önce tüm bilgileri, uyarıları ve notları okuyun.

ÜRÜN TANIMI VE GENEL BİLGİLER

1. TOKUYAMA BOND FORCE II, tek bileşenli, kendinden asitli, tek aşamalı (ayrıca selective etching ve total etching sistemlide kullanılabilen) tek kat uygulanmalı, mükemmel tutunma ve yapışma gücü ile ışıkla sertleşen, dental yapıştırıcı sistemi özellikleri ile kesilmiş / kesilmemiş mine ve dentinde olağanüstü marjinal bütünlük sağlayan, ışınlı ve dual cure sertleşen üniversal bonding ajanıdır.
2. TOKUYAMA BOND FORCE II, (470Nm yoğunluğunda, 500 nm 400 spektrum dalga boyu aralığına sahip bir ışınli cihaz ünitesi ile, Camphorquinone (CQ) maddesini sertleştirmede kullanılabilir.
3. TOKUYAMA BOND FORCE II, 3D SR Monomeri, Fosforik asit ester monomeri Bisfenol A di (2-hidroksi propoksi) dimetakrilat (Bis-GMA), trietilen glikol dimetakrilat (TEGDMA), 2-hidroksietil metakrilat, Camphorquinone, alkol ve artırılmış su içerir. Bölgesel dağıtımdan hemen sonra pH seviyesi yaklaşık 2.8olmaktadır.
4. TOKUYAMA BOND FORCE II, 3 (üç) değişik taşıyıcı sistemi ile beraber kullanılmaktadır. Bunlar; Şişe, Kalem tipi ve Tek kullanımlık doz halindedir. Size uygun olanı için yerel distribütörünüze danışınız.
5. Tokuyama Bond Force II nin içerdiği 3D SR monomer teknolojisi faz ayırımı elemine eder ve bu sayede hibrit tabakada homojen bir yapı oluşturur.
6. Tokuyama Bond Force II nin içerdiği 3D SR monomer teknolojisi sayesinde açığa çıkmış metal yüzeylerin yapıştırılmasında ek bir metal primer kullanılmaya gerek yoktur.
7. Tokuyama Bond Force II, Total Etch , Self Etch ve Selective Etch teknikleri ile kullanmaya uygundur.
8. Tutunma kuvveti: Mine:32 Mpa / Dentin: 28 Mpa
9. Deminerilizasyon derinliği 0,8 µm (Dentin&Mine)

ENDİKASYONLARI

- İşıklı veya dual-cure kompozitlerin yapıştırılmasında
- Direkt veya indirekt restorasyonların yapıştırılmasında,
 - Kesilmiş / kesilmemiş minede,
 - Kesilmiş/ kesilmemiş dentinde,
 - Kırık porselen / kompozitlerin tamirinde,
 - Hassasiyet giderici olarak ve kök yüzeyi hassasiyeti tedavisinde,
 - Pit ve fisür örtücülerle beraber kavite ve dentin verniği olarak,
 - Cam iyonomer simanlarla beraber koruyucu cila olarak,
 - Seramik, ormoserler ve compomerlerin tamirinde,
 - Metal destekli porselen restorasyonlarında kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

TOKUYAMA BOND FORCE II metakrilik monomerleri, organik çözücüler ve asitler içerir. Bu kimyasallara allerjisi olan hastalarda TOKUYAMA BOND FORCE II kullanmayınız.

ÖNLEMLER

- 1) Bu talimatlarda listelenenler dışında herhangi bir amaç için TOKUYAMA BOND FORCE II'yi kullanmayınız.
 - 2) TOKUYAMA BOND FORCE II Sadece lisanslı profesyonellerin diş bakımıyla ilgili satışı ve kullanımı için tasarlanmıştır Şişesi tahrir olmuş TOKUYAMA BOND FORCE II'yi kullanmayın.
 - 4) Alerjik reaksiyon gösteren ya da aşırı hassasiyet ortaya çıkan hastalarda TOKUYAMA BOND FORCE II kullanmayı derhal bırakın.
 - 5) TOKUYAMA BOND FORCE II kullanırken alerjik reaksiyonların olasılığını önlemek için her zaman muayene eldivenleri (plastik, vinil veya lateks) kullanın.
- Not: Metakrilik monomerleri gibi bazı maddeler muayene eldivenleri gibi malzemelere nüfuz edebilir.
- TOKUYAMA BOND FORCE II muayene eldivenleri ile temas ederse temizlemek için eldivenleri imha edin ve ellerinizi kısa sürede su ile iyice yıkayın.
- 6) Gözünüzün, mukozanın, deri ve diğer giysilerinizin TOKUYAMA BOND FORCE II ile temasından kaçının.
 - TOKUYAMA BOND FORCE II gözlerle temas ederse su ile derhal iyice yıkayınız ve derhal bir göz doktoruna başvurun.
 - TOKUYAMA BOND FORCE II mukozal membran ile temas ederse, hemen etkilenen bölgeyi silin ve sonra iyice su ile yıkayın.
- Restorasyon tamamlandıktan sonra etkilenen alanlarda protein pıhtılaşmasından meydana gelen beyazlık olabilir, bu tür beyazlık 24 saat içinde kaybolur. Bu tür beyazlaşma 24 saat içinde kaybolmaz ise hastanın hemen bir doktora başvurması tavsiye edilir.- TOKUYAMA BOND FORCE II deri ya da giysilerle temas ederse, hemen alkol emdirilmiş pamuklu çubukla ya da gazlı bez ile bölgeyi ovalayarak temizleyiniz.
- Tedaviden sonra hemen ağızını durulayın hastayı bilgilendirin.
- 7) TOKUYAMA BOND FORCE II yutulmamalı veya aspire edilmemelidir. Yutma veya aspirasyon ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- 8) TOKUYAMA BOND FORCE II'nin yanlışlıkla kullanılmasını engellemek için hastaların ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
- 9) TOKUYAMA BOND FORCE II yanıcıdır. Ateşe maruz bırakmayınız.
- 10) Çapraz enfeksiyonu engellemek ve tutunma gücünün düşmesini engellemek için, her kullanımdan sonra alkol ile taşıyıcının ucunu iyice temizleyin.
- 11) TOKUYAMA BOND FORCE II'yi doğrudan veya yakın olarak pulpa üzerinde kullanmayınız.
- Pulpaya yakın bölgede cam iyonomer astar veya kalsiyum hidroksit ile koruma tavsiye edilir.
- 12) Işıklı dolgu cihazı kullanırken göz koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
- 13) Bir restorasyon yanlış hizalanmışsa, oklüzyonu düzgün değilse veya brüksizmden dolayı restorasyon çatlayabilir, bu durumda restorasyon tekrarlanmalıdır.
- 14) Diğer marka primer veya bond ile TOKUYAMA BOND FORCE II'yi karıştırmayınız.

15) TOKUYAMA BOND FORCE II soğuk ortamda depolanmış ise kullanmadan önce bir-iki dakika oda sıcaklığına getirilmelidir.

- 16) Bond Force Kalem tipini kullanıyorsanız,
 - Kapağı kapalı iken düğmeye BASMAYINIZ.
 - Bond çıkan uç yukarı bakarken düğmeye BASMAYINIZ.
 - Bond çıkarma sırasında Kalem tipini çapraz veya yatay TUTMAYIN.
 - Kalem tipini ağız boşluğuna doğrudan tutmak sureti ile KULLANMAYIN.
 - Kalemli sökmeye ÇALIŞMAYIN.

İLAÇLAR VE MALZEMELER İÇİN ÖNLEMLER

- 1) Bazı malzemeler ve ilaçlar (hemostatik malzeme gibi) TOKUYAMA BOND FORCE II'nin yapışmasını engeller. Hata ile bulaşmışsa dikkatli bir şekilde uzun bir süre su ile titiz bir temizlik yapın.
- Aşağıda belirtilen maddeleri içeren ürünleri beraber KULLANMAYIN:
- Öjenol,
 - Diammine gümüş florür [moleküler formülü: Ag (NH3) 2F],
 - Örneğin parachlorophenol, guaiakol, fenol gibi fenoller,
 - Alüminyum klorür,
 - Ferrik sülfat,
 - Alüminyum sülfat,

- 2) TOKUYAMA BOND FORCE II, aşağıdaki maddelerin kullanımından sonra uygulanırsa dişe bağlanmayabilir,
 - Hidrojen peroksit (oxydol),
 - Sodyum hipoklorit
- Bu maddeler simantasyondan sonra genellikle beş gün içinde yok olur. Bu maddelerin kanal tedavisinde inhibisyonundan sonra kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

DEPOLAMA

- 1) TOKUYAMA BOND FORCE II'yi 0- 25 ° C santigrat derece (32- 77 °F) arasındaki bir sıcaklıkta saklayınız.
- 2) Uzun zaman kullanılmayacak ise serin ve karanlık bir ortamda saklayınız.
- 3) Isıdan, doğrudan güneş ışığından, kıvılcıklardan ve açık alevden uzak tutunuz.
- 4) Şişe / paket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

BERTARAF ETME

-Kullanılmayan TOKUYAMA BOND FORCE II'yi emici ve absorbe edebilecek gazlı bez veya pamuk ile yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz.

KLİNİK PROSEDÜR

1. Temizlik
- Diş yüzeyini bir lastik yardımı ile florür içermeyen diş macunu ile temizleyiniz. Ardından su ile iyice yıkayınız.
2. İzolasyon
- Rubber Dam ile izolasyon tercih edilen yöntemdir.
3. Kavitenin hazırlanması

Kaviteyi hazırlayın ve su ile durulayın. Anteriyorda marjınleri belirleyin (sınıf III, IV, V), posteriorda preparatların yanı sıra, olukları ve marjınleri belirleyin (sınıf I, II).

Kavitedeki oluklar, konik bölünmeler ve marjınlerin belirlenmesi hem estetik açıdan daha iyi olacaktır hemde bondun tutunma gücünü artıracaktır.

- Kesilmemiş minede yapışkan bir yüzey olması için aşındırma maddesi kullanılır.
- Porselen / kompozit restorasyonunda, elmas bir frez ile yüzeyi pürüzlendiriniz.
- Fosforik asit kullandıktan sonra su ile durulayınız. Ardından hava ile iyice kurulayınız.
-Tokuyama Bond Force II nin içerdiği SR monomer teknolojisi sayesinde açığa çıkmış metal yüzeylerin yapıştırılmasında ek bir silan kullanılmaya gerek yoktur.

Diş Yüzeyine Asit Uygulama (İsteğe Bağlı)

Klinik olarak yeterli yapışma kuvveti elde edilmektedir. Fakat, daha yüksek bağlanma için uygulanacak yüzeye aşağıdaki asitleme prosedürleri uygulanabilir:

a) Mine Asitleme Sistemi (Selective Enamel Etching) Prosedürü

Dentinin istenmeden aşındırılması sonucunun yapıştırma üzerinde herhangi bir zararlı etkisi yoktur.
Yaygın olarak kullanılan (yaklaşık% 35)'lik, bir fosforik asit aşındırma jelini hazırlanmış veya hazırlıksız diş minesine sürünüz ve 15 saniye bekleyiniz. Bekledikten sonra, su ile iyice yıkayınız. Ardından yağsız kuru hava uygulayın pamuk pelet ile hafifçe kurulayınız. Bölgeyi tamamen kurutmayınız.

b) Total Asitleme Prosedürü (Total Etching)

Yaygın olarak kullanılan (yaklaşık% 35)'lik, bir fosforik asit aşındırma jelini hazırlanmış veya hazırlıksız diş minesine sürünüz ve 15 saniye bekleyiniz. Bekledikten sonra, su ile iyice yıkayınız. Ardından yağsız kuru hava uygulayın pamuk pelet ile hafifçe kurulayınız. Bölgeyi tamamen kurutmayınız.

4. Kurutma

Kurutma kağıdı ya da bir hava şırıngası ile kaviteyi kurutun.
- Vital dişte kullanırken uygulanan bölgeyi tamamen kurutmayınız.
- Diş yüzeyinde kalıntı vb. maddeler varsa yüzey aşağıda belirtildiği şekilde temizlenmelidir.
Alkol veya sitrik asit ile diş yüzeyi ile temizlenir.
Airetör, Hava şırıngası veya Piyasemenden aşağıdaki maddeler yüzeye bulaşırsa uygulamadan önce 2-3 saniye fosforik asit uygulanabilir.
1) Yağ buharı,
2) Tükürük, kan ve dişkaları.

5. Pulpa Koruma

Kaviteye pulpa yakın ise cam iyonomer astar ya da kalsiyum hidroksit uygulanmalıdır
Korumak için ZOE esaslı MALZEMELERİ KULLANMAYIN.
Bu malzemeler TOKUYAMA BOND FORCE II kürünü inhibe eder.

6. TAŞIYICI / DAĞITICI

6-1. Tek Kullanımlık Doz

Kapağı açın ve tek aplikatörü batırın.
- Kapağı açarken kabın üst ve altından emin olun.
- Çapraz enfeksiyonu önlemek için, kalan malzeme diğer hastalarda kullanılamaz.
6-2. Şişe kapağını çıkararak, şişeye biraz sıkarak kuvvet uygulayın, bir iki damla gelecektir.Kullandıktan sonra kapağı sıkıca kapatınız.
- TOKUYAMA BOND FORCE II'yi damlatırken şişeyi her zaman dikey tutunuz.
Damlatma sırasında şişeyi yatay ve çapraz tutmayınız, bond şişe ucundan geri akar, kirlenir .
- Kapağı kapamadan önce şişenin ucundaki fazla bond damlalarını siliniz.

6-3. Kalem Tipi Bond

Kapak yukarı bakacak şekilde, kapağını açarak, açın ve aşağı doğru dik bir vaziyette çeviriniz.
Dikey olarak bir yada iki damla düşene kadar, iki veya üç defa düğmeye basınız.
Bondun akışı düğmeye basılma şekline ve kalemin tutulduğu pozisyona bağlıdır.
Bondu damlattıktan hemen sonra bondun kapağını sıkıca kapatınız.
- Bondu damlatma sırasında kalemi dikey tutunuz. Çapraz ve ya yatay tutmak bondun uç kısımdan geri gitmesine ve kontaminasyona sebep olabilir.
- Kapanış öncesinde kalemin ucundan fazla yapıştırıcıyı silin.

Kalem Tipi Bond Göstergesi:

Gösterge kullanıcıların kalan yapıştırıcı miktarını izlemesini sağlar.
Siyah hat malzeme azaldıkça E noktasına hareke eder. Zaman çizgisi E ye yaklaştığında bu kalemin içerisindeki bondun neredeyse bittiğini gösterir. Yalnız bu kesin bir okuma değildir. Geride kalan malzemenin bir göstergesidir.

7. Uygulama

Tek aplikatör kullanarak, yüzeye TOKUYAMA BOND FORCE II uygulayın ve 10 saniye bekleyin.
- TOKUYAMA BOND FORCE II yi tüm yüzeylere sürdüğünüzden emin olun.
- Uygulamadan önce aplikatörü ve bond sürülen yüzeyi ışıktan koruyunuz.
Birim Doz: Birim Doz kapta aplikatörü tutun.
Şişe, Kalem: Bir ışık engelleme plakası kullanın.
BOND FORCE II uçuca bir alkol içerir.
- TOKUYAMA BOND FORCE II' nin subgingival bölgeye akmasına izin vermemek için dikkatli olun.
. TOKUYAMA BOND FORCE II Subgingival bölgeye akar ise, iyice yıkayın ve bölgeyi kurulayın.
- TOKUYAMA BOND FORCE II yi Seramik yüzey, porselen veya kompozit yüzeye uygulayacaksınız, gerekli prosedürlere dikkat ediniz.

8. Hava ile Kurulama

Yağsız bir hava / su şırıngası kullanılarak, TOKUYAMA BOND FORCE II yi sürdükten sonra, 5 saniye boyunca aynı pozisyonda hareket olmadan sürekli hafif derecede hava uygulayınız.
Bir vakumlu aspiratör kullanırsanız yapıştırıcı lekesini önlersiniz.
- Kazara sıçrama olursa, dokuyu beyazlatılabilir veya alerjik reaksiyon oluşabilir.
- Yapıştırıcı kavite tabanına veya yüzeye fazla akarsa, aşırı yapıştırıcı tek kullanımlık aplikatör ile fazlalık alınabilir veya çok hafif bir hava ile inceltilebilir.
- Kaviteye tükürük, kan veya diğer sıvılar bulaşırsa, veya yapıştırıcı kontamine olursa, kaviteyi iyice su ile durulayın, kuruladıktan sonra yeni yapıştırıcıyı yeniden uygulayın.
- Kastızsız kirlenme dışında su ile uygulanan yapışkan üzerinde durulama yapmayın.

9. İşılama

Yüzeyden 2 mm mesafeden ışınlı dolgu cihazı ile en az 10 saniye sürede ışın tutunuz.
Kavite çok büyük olursa 2 mm lik mesafeden bölme bölme ışınlayınız.

- Işın cihazını uygulamadan önce cihazın ışın yoğunluğunun en az (> 300 mW / cm²) olduğunu doğrulayın. Bunun için bir ışın ölçer kullanabilirsiniz.

DİKKAT: Yasalarımız bu ürünün satışını profesyoneller ile sınırlar.

ÖNEMLİ NOT: Hatalı kullanımdan dolayı kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan üretici firma sorumlu değildir.
Bu ürünün hatasız kullanımı sağlamak kullanıcının kişisel sorumluluğudur.
Bu ürün, kullanım öncesi uygun bir uygulama için uygundur.
Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün özelliklerinden başka talimatlar ve tedbirler de değişebilir.

Üretici:

Tokuyama Dental Corporation

38-9, Taitou 1- chome, Taitou-ku, Tokyo, Japan
Tel: +81-3-3835-7201
www.tokuyama-dental.com

Avrupa Temsilcisi

Tokuyama Dental Italy S.r.l.

Via dell' Artigianato, 7,
36030 Montecchio Precalcino, Vicenza, Italy
www.tokuyama.it

Türkiye Temsilcisi

Dünya Dental Sag.Ar. Ger Ltd.Sti

Tokuyama Dental Türkiye

Yüksel cad. No:34/1 Kızılay- Ankara
0312 430 55 16
www.tokuyamaturkiye.com